BN-TG 系列

# 单组份可剥离导热凝胶

## ■产品用途

用于图形处理器、平板显示器、内存及电源模块、电源&半导体的散热

## ■产品特点

- 高导热系数、低热阻、良好的界面润湿性
- 低热阻值、低油份渗出、低装配间隙要求
- 柔软性高、耐高温、耐腐蚀
- 抗震性强、耐电晕和耐化学介质性
- 低的压缩应力、抗垂流性能好
- 易存储、低附着力、可轻松剥离无残留
- 无有害物质，无味、对基材无腐蚀
- 可室温固化或加热固化，固化后具有一定拉伸强度的弹性体

## ■产品规格

| 型号 | 外观形态 | 密度（$g/cm^3$） | 导热系数 (W/m·K) | 挤出速率（g/min） | 体积电阻率（Ω·cm） | 介电强度 (KV/mm) | 硬度 (shore OO) | 拉伸强度（Mpa） | 伸长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-TG620H | 蓝色膏状 | 2.7 | 2.0 | 120-300 (可调) | $10^{13}$ | > 10 | 60-75 | 0.3 | 300 |